# Bi 底层对 FePt 薄膜的影响\*

闪 春<sup>1</sup>) 李宝河<sup>12</sup>, 韩 刚<sup>1</sup>) 滕 蛟<sup>1</sup>, 姜 勇<sup>1</sup>) 刘泉林<sup>1</sup>, 于广华<sup>1</sup>

1 (北京科技大学材料物理与化学系,北京 100083)
2 (北京工商大学数理部,北京 100037)
(2006年4月29日收到2006年8月7日收到修改稿)

利用磁控溅射的方法,在玻璃基片上制备了以 Bi 为底层的 FePt 薄膜,经不同温度真空热处理得到 Ll<sub>0</sub>-FePt 薄膜.研究了 Bi 做底层对 FePt 薄膜的有序化温度及矫顽力  $H_c$  的影响.实验结果表明:以 Bi 做底层的 FePt 薄膜在 350  $\mathbb{C}$ 实现低温有序,同时其  $H_c$  也有大幅度提高,并且可以在更大成分范围内获得  $H_c$  较高的 Ll<sub>0</sub>-FePt 薄膜.利用 X 射线光电子能谱研究了薄膜中 Bi 原子的分布情况,利用 X 射线衍射研究了薄膜的晶体学结构变化.结果表明,Bi 底层在退火过程中的扩散促进了 FePt 薄膜有序度的升高.

关键词:L1<sub>0</sub>-FePt 薄膜,有序化温度,底层,扩散 PACC:7550S,7550V,7570A

## 1.引 言

L1<sub>0</sub>-FePt 有序合金薄膜,由于其具有较高的单 轴磁晶各向异性能 高达  $7 \times 10^6$  J/m<sup>2</sup> ) 较高的矫顽 力以及较好的耐腐蚀性,成为未来超高密度磁记录 介质的首选材料<sup>1-3]</sup>. 而直接溅射得到的 Fesa Ptsa薄 膜为无序的面心立方(fcc)结构,必须通过基片加热 或较高温度(高于 500 ℃)45]的退火才能形成有序 四方(fet)结构的Ll<sub>0</sub>-FePt相.过高温度退火会形成 较大的 FePt 晶粒和较粗糙的表面,不利于实现超高 密度磁记录,因此,降低 FePt 薄膜的有序化温度是 亟待解决的问题,目前降低 FePt 薄膜有序化温度的 方法主要有利用[Fe/Pt]]多层膜结构<sup>67]</sup>、离子辐 照<sup>[8]</sup>、掺加第三种元素<sup>[9—11]</sup>和引入不同的底层或顶 层<sup>[12-14]</sup>.利用这些方法制备出的薄膜在 300-400 ℃ 退火后的矫顽力 H。较低(低于 500 kA/m),仍不能 满足未来超高密度磁记录的需要[15].因此,除了要 实现 FePt 薄膜的低温有序化外,还要保证薄膜在较 低温度退火后具有较高的 H\_..我们过去的工作<sup>16]</sup>表 明 表面活化剂 Bi 元素的表面能较低(382 mJ/m<sup>2</sup>), 将 Bi 插入磁性薄膜中能够改善薄膜结构,导致磁性 提高.到目前为止,利用 Bi 做底层优化 L1₀-FePt 合

金结构并改善其磁性的报道还很少见到.本文的工作是利用 Bi 做底层 同时实现了 L1<sub>0</sub>-FePt 薄膜的低温有序化和薄膜磁性的改善.

#### 2. 实 验

所有薄膜均在 DV-502 型磁控溅射仪中制备,其 本底真空度为 5×10<sup>-5</sup> Pa. 我们过去的工作<sup>171</sup>表明, 只有 Fe 的含量在 46at%—56at% 之间,FePt 薄膜才 具有良好的磁性能.所以我们通过精确控制 Fe,Pt, Bi 靶( 纯度 99.99%)的溅射功率来制备样品结构为 玻璃基片/Bi ( 20 nm)/Fe<sub>x</sub>Pt<sub>100-x</sub>( 20 nm)和玻璃基 片/Fe<sub>x</sub>Pt<sub>100-x</sub>( 20 nm)的薄膜( x = 43—55).样品中 Fe,Pt 的含量由电感耦合等离子体原子发射光谱 (ICP-AES)测定.所有薄膜均在室温、Ar 气氛下沉积, Ar 气压恒定在 0.45 Pa 基片以 18 r/min 的速率旋转. Bi 和 FePt 的沉积速率分别为 0.01 和 0.14 nm/s.沉积 后得到的薄膜经真空度为 3×10<sup>-5</sup> Pa 的真空退火处 理,退火温度为 300—550 ℃ 退火时间为 20 min.

利用 MicroMag2900 型交变梯度磁强计(AGM)测量样品的磁性,外加磁场方向平行于膜面,最大磁场强度为1432 kA/m.采用 X 射线衍射(XRD)分析样品的晶体结构.利用 X 射线光电子能谱(XPS)分析表

† 通讯联系人.E-mail:ghyu@mater.ustb.edu.cn

<sup>\*</sup> 教育部博士点基金(批准号 2003008003) 教育部科学技术研究重点项目(批准号 :104023)和教育部新世纪优秀人才支持计划(批准号: NCET-04-0104)资助的课题.

层元素的化学状态. XPS 实验细节以及 XPS 的探测 深度 *d* 在文献[13]中已有报道. 本文的 XPS 实验 中, Bi 原子的探测深度 *d* 为 6.45 nm.

#### 3. 结果及讨论

图 1 是无底层和以 Bi 为底层的  $Fe_x Pt_{100-x}$ 薄 膜(x = 43-55),  $2400 \ C$  退火 20 min 后, 平行膜 面矫顽力 $H_c$  随 Fe 的原子含量 x 的变化曲线. 在 400 C 退火后,  $Fe_x Pt_{100-x}$ 薄膜的  $H_c$  随成分的变化 较大,  $H_c$  较大的薄膜仅局限于 x = 49-55之间. 而 Bi/Fe\_x Pt\_{100-x} 薄膜的  $H_c$  受成分的影响较小, 均保持 高于 850 kA/m. 说明以 Bi 为底层可以大幅度地提高 同成分的 FePt 薄膜的  $H_c$ ,并可以在更大成分范围 内获得  $H_c$  较高的 L1<sub>0</sub>-FePt 薄膜. 图 2 是 Fe<sub>49</sub> Pt<sub>51</sub> 和 Bi/Fe<sub>49</sub> Pt<sub>51</sub> 薄膜在 400 C 退火 20 min 后的磁滞回线. 以 Bi 为底层的 Fe<sub>49</sub> Pt<sub>51</sub> 薄膜的  $H_c$  ;同时其剩 磁比达到了 0.93,这种在低温退火时具有高  $H_c$  和 剩磁比的 L1<sub>0</sub>-FePt 薄膜,符合未来超高密度磁记录 介质的要求.



图 1 Fe<sub>x</sub>Pt<sub>100-x</sub>(20 nm)和 Bi (20 nm)/Fe<sub>x</sub>Pt<sub>100-x</sub>(20 nm)薄 膜经 400 ℃退火 20 min 后 ,薄膜的平行膜面矫顽力 H<sub>c</sub> 随 Fe 含量 x 的变化曲线

为了了解 Bi 底层对 FePt 薄膜  $H_a$  提高的原因, 我们选取 Fe<sub>49</sub> Pt<sub>51</sub> 样品,首先利用 XPS 研究了 Bi (20 nm)/ Fe<sub>49</sub> Pt<sub>51</sub>(20 nm)薄膜在无退火、400 和 550 ℃退 火后的 Bi 原子分布情况 图 3 给出了 Bi 元素的高分 辨 XPS.图 3 曲线 b 出现微弱的 Bi 峰,说明样品沉积 完毕后 Bi 底层中仅有少量的 Bi 原子扩散到 Fe<sub>49</sub> Pt<sub>51</sub> 薄膜的表面.而图 3 曲线 a 却出现了较强的 Bi 4 $f_{7/2}$ 和



图 2 薄膜在 400 ℃退火 20 min 后的磁滞回线 外加磁场 平行于膜面.曲线 *a* 为 Fe<sub>49</sub> Pt<sub>51</sub>(20 nm)薄膜,曲线 *b* 为 B(20 nm)Fe<sub>49</sub> Pt<sub>51</sub>(20 nm)薄膜

4 $f_{5/2}$ 峰,说明当退火温度  $T_a$  升高到 400 ℃时已有大量 的 Bi 原子扩散到表面.图 3 曲线 c 无明显的 Bi 峰,说 明当  $T_a = 550$  ℃时大量扩散到表面的 Bi 原子又消失 了 这是由于 Bi 具有较低的饱和蒸气压,表面的 Bi 原子在高温退火时升华后离开薄膜的缘故<sup>181</sup>.



图 3 B(20 nm)/Fe<sub>49</sub>Pt<sub>51</sub>(20 nm)/薄膜中表面 Bi 元素的 XPS 曲线 *a* 为 *T*<sub>a</sub> = 400 ℃,曲线 *b* 为退火前,曲线 *c* 为 *T*<sub>a</sub> = 550 ℃

我们还对  $F_{e_{49}}P_{t_{51}}$ (20 nm)和 Bi (20 nm)/ $F_{e_{49}}P_{t_{51}}$ (20 nm)/薄膜退火后的晶体学结构变化进行了研究, 图 4 显示了 350 和 550 ℃退火后薄膜的 XRD 谱.从 图 4(a)可以看出,经 350 ℃真空退火后,无底层的  $F_{e_{49}}P_{t_{51}}$ 薄膜仅出现 FePt 基本衍射峰;而 Bi/FePt 薄膜 不仅出现了 Bi 衍射峰和 FePt 基本衍射峰,还有明显 的 L1<sub>0</sub>-FePt 超晶格衍射峰,即已经发生了由 fcc 相向 fct 相的转变.说明利用 Bi 做底层,可以将 Fe<sub>49</sub>  $P_{t_{51}}$ 薄膜的有序化温度降低到 350 ℃.为定量描述 L1<sub>0</sub>-FePt 薄膜的有序化程度,有序度参数 S 定义为<sup>[19]</sup>

$$b^{2} = \frac{1 - (c/a)}{1 - (c/a)_{S_{c}}}, \qquad (1)$$

式中  $(c/a)_{s_c}$  为完全有序的 fet 结构的晶格参数之 比,为0.961<sup>[19]</sup> (c/a)可由各 XRD 谱中的超晶格衍 射峰和基本衍射峰确定,图5给出了 FePt 晶格的 c/a 值随 T。的变化情况.对于 Bi/Fea Pts1 薄膜 350 ℃ 退火后 c/a 值小于 1,证明了此时的 FePt 晶格为四 方结构,但此时的纯 FeaoPtsi 薄膜中的 FePt 晶格仍呈 现立方结构 ;同时 Bi/Fe<sub>4</sub> Pt<sub>51</sub>薄膜的 c/a 值明显地小 于同温度退火后的纯  $Fe_{40} Pt_{51}$ 薄膜的 c/a 值,说明与 纯 Fea Pts 薄膜相比,以 Bi 为底层的 Fea Pts 薄膜形 成了有序化程度更高的具有 L1。相的 FePt 四方晶 格 即以 Bi 为底层可以促进 FePt 薄膜的有序化进 程.由于 FePt 薄膜矫顽力的大小主要受 FePt 薄膜的 有序化程度影响<sup>20]</sup>,所以以 Bi 为底层提高了 FePt 薄膜的 H\_...此时图 4(b)中未出现任何 Bi 的衍射峰, 说明薄膜中的 Bi 原子完全消失 这与图 3 曲线 c 的 XPS 结果一致 同时又一次证明了表面的 Bi 在高温 退火时发生的升华现象.



图 4 Fe<sub>49</sub> Pt<sub>51</sub>(20 nm)薄膜和 Bi(20 nm)Fe<sub>49</sub> Pt<sub>51</sub>(20 nm)薄膜 在不同温度下退火 20 min 后的 XRD 谱 (a) T<sub>a</sub> = 350 ℃, (b) T<sub>a</sub> = 550 ℃

根据以上 XPS 和 XRD 结果分析可知,薄膜沉积 完毕后,大部分 Bi 原子处在薄膜的底层,未发生扩 散,此时它对 L1<sub>0</sub>-FePt 结构转变的影响较小,使得溅 射态的 Bi/FePt 薄膜和纯 FePt 薄膜相同,具有较低 的  $H_{e}$ .随着  $T_{a}$  的升高,Bi 原子将逐渐扩散到样品的 表面,使得以 Bi 为底层的 FePt 薄膜比纯 FePt 薄膜 更有利于实现由 fee 结构向 L1<sub>0</sub>结构的转变,其有序 度比纯 FePt 薄膜高,从而促进  $H_{e}$  的升高.



图 5 Fe<sub>49</sub> Pt<sub>51</sub>(20 nm)薄膜和 B(20 nm)/Fe<sub>49</sub> Pt<sub>51</sub>(20 nm)薄膜中 FePt 晶格的 *c*/*a* 值随 *T*<sub>a</sub> 的变化曲线

与 Fe, Pt 原子相比, Bi 原子具有较大的原子半 径和较小的表面能,所以 Bi 原子在 FePt 晶格中的溶 解度较小,并且很容易在较低温度的退火过程中扩 散到 FePt 薄膜的表面. Kitakami 等<sup>181</sup>报道,在 Bi 扩 散过程中会给 CoPt 薄膜带来大量的缺陷.由于 L1<sub>0</sub>-FePt 和 L1<sub>0</sub>-CoPt 具有相同的晶体学结构以及相类似 的晶体学参数,所以 Bi 扩散也会在 FePt 薄膜中产生 大量缺陷,带动 Fe, Pt 原子的重新有序排列.这就导 致以 Bi 为底层的 FePt 薄膜可以在较低的温度下实 现有序化转变,即降低了有序化温度,同时大大提高 相同温度下退火后 FePt 薄膜的有序化程度,使得薄 膜的 H<sub>c</sub> 大幅度升高.

#### 4.结 论

本文利用 Bi 做底层,降低了 FePt 薄膜的有序化 温度,并大幅度提高薄膜的  $H_e$ ,同时可以在更大成 分范围内获得  $H_e$ 较高的 L1<sub>0</sub>-FePt 薄膜.经 350 ℃真 空退火后,以 Bi 做底层的 Fe<sub>49</sub> Pt<sub>51</sub>薄膜就实现了有序 化转变 400 ℃退火 20 min 后,Bi/Fe<sub>49</sub> Pt<sub>51</sub>薄膜的  $H_e$ 

### 达到 1074.3 kA/m ,*M*,/*M*,达到 0.93. Bi 做底层促进 了 FePt 薄膜的有序化 ,其原因与 Bi 元素在退火过程

中的扩散有关.

- [1] Weller D, Moser A, Folks L et al 2000 IEEE Tran. Magn. 36 10
- [2] Weller D , Moser A 1999 IEEE Tran . Magn . 35 4423
- [3] Sun S , Murray C B , Weller D et al 2000 Science 287 1989
- [4] Kuo C M , Kuo P C , Wu H C *et al* 1999 J. Appl. Phys. **85** 4886
- [5] Yang T, Kang K, Yu G H et al 2002 J. Phys. D: Appl. Phys. 35 2897
- [6] Zhu Y, Cai J W 2005 Acta Phys. Sin. 54 393 (in Chinese)[竺 云、蔡建旺 2005 物理学报 54 393]
- [7] Shima T , Moriguchi T , Mitani S et al 2002 Appl. Phys. Lett. 80 288
- [8] Ravelosona D, Chappert C, Mathet V et al 2000 Appl. Phys. Lett. 76 236
- [9] Maeda T, Kai T, Kikitsu A et al 2002 Appl. Phys. Lett. 80 2147
- [10] Li B H, Feng C, Yang T et al 2006 Acta Phys. Sin. 55 2567 (in Chinese) [李宝河、冯 春、杨 涛等 2006 物理学报 55 2567]
- [11] Lee S R , Yang S , Keunkim Y et al 2001 Appl. Phys. Lett. 78

4001

- [12] Xu Y F , Chen J S , Wang J P 2002 Appl . Phys . Lett . 80 3325
- [13] Zhang L J, Cai J W, Meng F B et al 2006 Acta Phys. Sin. 55 450 (in Chinese)[张丽娇、蔡建旺、孟凡斌等 2006 物理学报 55 450]
- [14] Zhao Z L , Ding J , Inaba K et al 2003 Appl . Phys . Lett . 83 2196
- [15] Wood R 2000 IEEE Tran. Magn. 36 36
- [16] Yu G H , Li M H , Zhu F W et al 2003 Appl. Phys. Lett. 82 94
- [17] Li B H, Feng C, Yang T et al 2006 J. Phys. D: Appl. Phys. 39 1018
- [18] Kitakami O , Shimada Y , Oikawa K et al 2001 Appl. Phys. Lett. 78 1104
- [19] Endo Y, Kikuchi N, Kitakami O et al 2001 J. Appl. Phys. 89 7065
- [20] Sellmyer D J , Luo C P , Yan M L et al 2001 IEEE Tran. Magn. 37 1286

### The effect of a Bi underlayer on FePt thin film \*

Feng Chun<sup>1</sup>) Li Bao-He<sup>1,2</sup>) Han Gang<sup>1</sup>) Teng Jiao<sup>1</sup>) Jiang Yong<sup>1</sup>) Liu Quan-Lin<sup>1</sup>) Yu Guang-Hua<sup>1,†</sup>

1) Department of Materials Physics and Chemistry, University of Science and Technology Beijing, Beijing 100083, China)

2 J Department of Mathmatics and Physics, Beijing Technology and Business University, Beijing 100037, China)

(Received 29 April 2006; revised manuscript received 7 August 2006)

#### Abstract

In this paper, the FePt films with Bi underlayer were prepared by dc magnetron sputtering on glass substrates. The Ll<sub>0</sub>-FePt films were obtained after the deposited samples were subjected to vacuum annealing at various temperatures. The effect of a Bi underlayer on the ordering temperature and magnetic properties of FePt films was studied. Experimental results show that the FePt film can realize the low-temperature ordering at 350 °C after introduction of a Bi underlayer. Moreover, the Bi underlayer can also obviously enhance the coercivity  $H_c$  of the film and enlarge the concentration range of FePt films with high  $H_c$ . We studied the distribution of Bi atoms by X-ray photoelectron spectroscopy and the change of crystal structure of FePt films by the Bi diffusion during annealing process.

Keywords :  $L1_0$ -FePt thin films , ordering temperature , underlayer , diffusion PACC : 7550S , 7550V , 7570A

<sup>\*</sup> Project supported by the Doctoral Foundation of Ministry of Education of China (Grant No. 2003008003), the Key Program of Science and Technology Research of Ministry of Education, China (Grant No. 104023) and the Program for the New Century Excellent Talents in University of Ministry of Education, China (Grant No. NCET-04-0104).

<sup>†</sup> Corresponding author. E-mail:ghyu@mater.ustb.edu.cn